

关于召开 2024PME 半导体设备关键零部件的表面质量提升挑战论坛的通知

各有关单位：

我国半导体产业正处于快速发展阶段，展现出了强大的增长潜力和国际竞争力。中国的芯片产业集聚区主要集中在长三角地区，该地区是国内最主要的集成电路开发和生产基地，产业规模在全国占比为 58.3%。中国集成电路产业分为三个发展阶段，目前正处于快速发展阶段，政府通过发布《中国制造 2025》等政策，提出了中国芯片自给率的目标。

以精密磨削、研磨、抛光、清洗、电镀、真空镀膜等为主的表面精密加工技术在半导体关键零部件制造中起着至关重要的作用，为了加快中国半导体领域不断取得技术突破，上海市集成电路行业协会会同汇捷通展览（上海）有限公司拟在上海组织召开 **2024PME 半导体设备关键零部件的表面质量提升挑战论坛**。会议将邀请来自表面精密加工技术头部企业与半导体关键零部件、半导体设备领域的用户共同交流，围绕应用痛点、分享案例和经验，促进行业技术交流，推动半导体领域技术与变革。

一、时间、地点

- 1、会议时间：2024 年 9 月 4 日（9 月 4 日上午报到）
- 2、会议地点：上海新国际博览中心 N4 馆 M45 会议室

二、组织架构

主办单位：上海市集成电路行业协会、汇捷通展览（上海）有限公司

承办单位：汇捷通展览（上海）有限公司

三、同期活动

- 1、活动名称：第二届表面精密加工技术博览会(PME2024)
- 2、活动时间：2024年9月3-5日
- 3、活动地点：上海新国际博览中心N4馆

四、会议内容

- 半导体领域超高纯洁净不锈钢管路电解化学抛光技术
- VCR 接头、阀门等半导体设备零部件的电解抛光技术
- 半导体设备零部件的清洗技术（清洁度控制）
- 半导体设备零部件涂层镀膜技术解决方案

五、参会群体

- 半导体关键零部件生产企业。
- 半导体设备生产企业。

六、参会须知

1、协会会员单位及符合条件的用户端、政府部门、行业组织、受邀机构等相关特邀嘉宾可免费参会。会议费包含

参会门票、会议资料，参会代表交通费及住宿费自理。预约报名截止日期为8月30日。

七、报名方式

请扫描以下二维码填写相关信息，审核通过后即可免费参会。



扫码报名

八、联系方式

参会、赞助、咨询：

毛老师，13917501597

郝老师，18410081936

贺雅宁，18519349122

*会议日程详见附件

上海市集成电路行业协会

2024年8月21日



附件

会议日程

2024PME 半导体设备关键零部件的表面质量提升挑战 论坛

议题 Topic	嘉宾 Speaker	职位 Position	单位 Company Name
开幕致辞 Opening Speech	郭奕武 Yiwu Guo	秘书长 Secretary General	上海市集成电路行业协会 Shanghai Integrated Circuit Industry Association
半导体关键零部件表面特性对芯片制程工艺的影响 Surface characteristics of semiconductor key components and their influence on chip manufacturing process	刘枫 Leo Liu	副总裁 CTO	富创精密设备股份有限公司 Shenyang Fortune Precision Equipment Co., Ltd.
半导体关键零部件的精密加工解决方案 Precision machining solutions for key semiconductor components	孙继腾 Jiteng Sun	销售经理 Sales Manager	斯达拉格机床（上海）有限公司 Starrag (Shanghai) Co., Ltd.
半导体装备洁净零部件设计、制造与应用 Design, Manufacturing and Application of Clean Components for Semiconductor Equipment	赵仁洁 Renjie ZHAO	先进制造中心 主任 Supervisor of Advanced Manufacturing Center	上海微电子装备（集团）股份有限 公司 Shanghai Microelectronics Equipment (Group) Co., Ltd
半导体设备零部件清洗技术 The Cleaning technology of Semiconductor equipment's part	徐菖松 Changsong Xu	供应商质量管 理经理 SQM	盛美半导体设备（上海）股份有限 公司 ACM Research (Shanghai), Inc.
半导体清洗中的数字化管控 Digital Control in Semiconductor Cleaning	张晶晶 ELLA	销售经理 Sales Manager	北京洁创环保科技有限公司 Beijing JC Environmental Protection Co., Ltd.
真空气相沉积碳基薄膜的结构与功能化设计 Structural and Functional Design of Carbon-based Films Deposited by Vacuum Vapor Deposition Technology	张广安 Guangan Zhang	研究员 Professor	中国科学院兰州化学物理研究所 固体润滑国家重点实验室 State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences
ALD 为半导体核心零部件镀膜提供的优势和应用 Benefits and application of Atomic Layer Deposition protective coatings for critical semiconductor equipment parts	Jaakko Sormunen	欧洲销售总监 Head of sales, BENEQ	青岛四方思锐智能技术有限公司 Qingdao Sifang SRI Intellectual Technology Co. LTD

<p>半导体芯片制造堆高洁净管材/管件表面质量控制技术探讨</p> <p>Discussion on Surface quality control technology of high clean pipe、 pipe fitting in semiconductor chip manufacturing</p>	<p>王琪</p> <p>Qi Wang</p>	<p>总经理</p> <p>CEO</p>	<p>上海脉诺金属表面处理技术有限公司</p> <p>Shanghai Mirror Metal Surface Treatment Technology Co. Ltd.</p>
<p>不锈钢等金属表面化学抛光除毛刺新技术</p> <p>New technology of chemical polishing and deburring of stainless steel and other metal surfaces</p>	<p>孙景志</p> <p>Sun Jing Zhi</p>	<p>教授</p> <p>Professor</p>	<p>禧求普半导体科技有限公司</p> <p>Chiptub Semiconductor Technology Co., LTD</p>